

中国集成电路封装行业发展现状及未来趋势分析报告2024 - 2030年

产品名称	中国集成电路封装行业发展现状及未来趋势分析报告2024 - 2030年
公司名称	鸿晟信合（北京）信息技术研究院有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区日坛北路19号楼9层(08)(朝外孵化器0530)（注册地址）
联系电话	010-84825791 15910976912

产品详情

中国集成电路封装行业发展现状及未来趋势分析报告2024 - 2030年【全新修订】：2024年4月【出版机构】：中智信投研究网【内容部分有删减·详细可参中智信投研究网出版完整信息！】【报告价格】：[纸质版]:6500元 [电子版]:6800元 [纸质+电子]:7000元 (可以优惠)【服务形式】：文本+电子版+光盘【联系人】：顾滢滢 李雪免费售后

服务一年，具体内容及订购流程欢迎咨询客服人员【报告目录】第1章 中国集成电路封装行业发展背景231.1集成电路封装行业定义及分类231.1.1集成电路封装行业定义231.1.2集成电路封装行业产品大类231.1.3集成电路封装行业特性分析24（1）行业周期性24（2）行业区域性24（3）行业季节性241.4集成电路封装行业在集成电路产业中的地位分析241.2集成电路封装行业政策环境分析251.2.1行业管理体制251.2.2行业相关政策26（1）《电子信息产业调整和振兴规划》26（2）《集成电路产业“十四五”发展规划》27（3）发改委加大对集成电路行业的支持力度31（4）科技部重点支持集成电路重点专项31（5）《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》32（6）海关支持软件产业和集成电路产业发展有关政策规定和措施331.3集成电路封装行业经济环境分析341.3.1国际宏观经济走势分析及预测34（1）国际宏观经济现状34（2）国际宏观经济预测361.3.2国内宏观经济走势分析及预测39（1）GDP增长情况分析39（2）工业经济增长分析40（3）固定资产投资情况41（4）社会消费品零售总额42（5）进出口总额及其增长42（6）货币供应量及其贷款43（7）居民消费者价格指数431.4集成电路封装行业技术环境分析441.4.1集成电路封装技术演进分析441.4.2集成电路封装形式应用领域451.4.3集成电路封装工艺流程分析461.4.4集成电路封装行业新技术动态47第2章 中国集成电路产业发展分析512.1集成电路产业发展状况512.1.1集成电路产业链简介512.1.2集成电路产业发展现状分析51（1）行业发展势头良好51（2）行业技术水平快速提升53（3）行业竞争力仍有待加强54（4）产业结构进一步优化542.1.3集成电路产业区域发展格局分析55（1）三大区域集聚发展格局业已形成55（2）整体呈现“一轴一带”的分布特征57（3）产业整体将“有聚有分，东进西移”572.1.4集成电路产业面临的发展机遇58（1）产业政策环境进一步向好58（2）战略性新兴产业将加速发展58（3）资本市场将为企业融资提供更多机会592.1.5集成电路产业面临的主要问题59（1）规模小59（2）创新不足60（3）价值链整合不够60（4）产业链不完善602.1.6集成电路产业“十四五”发展预测612.2集成电路设计业发展状况612.2.1集成电路设计业发展概况612.2.2集成电路设计业发展特征61（1）产业规模持续扩大61（2）质量上升数量下降62（3）企业规模持续扩大63（4）技术能力大幅提升632.2.3集成电路设计业发展隐忧632.2.4集成电路设计业新发展策略632.2.5集成电路设计业“十四五”发展预测642.3集成电路制造业发展状况642.3.1集成电路制造业发展现状分析64（1）集成电路制造业发展总体概

况64(2)集成电路制造业发展主要特点65(3)集成电路制造业规模及财务指标分析651)集成电路制造业规模分析652)集成电路制造业盈利能力分析663)集成电路制造业运营能力分析664)集成电路制造业偿债能力分析675)集成电路制造业发展能力分析672.3.2集成电路制造业经济指标分析68(1)集成电路制造业主要经济效益影响因素68(2)集成电路制造业经济指标分析69(3)不同规模企业主要经济指标比重变化情况分析70(4)不同性质企业主要经济指标比重变化情况分析72(5)不同地区企业经济指标分析752.3.3集成电路制造业供需平衡分析87(1)全国集成电路制造业供给情况分析871)全国集成电路制造业总产值分析872)全国集成电路制造业产成品分析88(2)全国集成电路制造业需求情况分析891)全国集成电路制造业销售产值分析892)全国集成电路制造业销售收入分析89(3)全国集成电路制造业产销率分析902.3.4集成电路制造业“十四五”发展预测91第3章中国集成电路封装行业发展分析923.1半导体行业发展分析923.1.1半导体行业指数对比分析92(1)费城半导体指数与道琼斯指数92(2)台湾电子零组件指数与台湾加权指数92(3)CSRC电子行业指数与沪深300指数933.1.2全球半导体产销分析94(1)全球半导体产值情况94(2)全球半导体销售情况953.1.3全球半导体行业主要企业情况99(1)全球半导体10qiang99(2)半导体情况1003.1.4中国半导体行业发展概况1023.1.5半导体设备BB值分析1023.1.6半导体行业景气预测1043.1.7半导体行业发展趋势106(1)产业链向化工转型106(2)综合厂商向轻资产转型106(3)封装环节产值逐年成长107(4)封装环节外包也是趋势1083.2集成电路封装行业发展分析1083.2.1集成电路封装行业规模分析1083.2.2集成电路封装行业发展现状分析1093.2.3集成电路封装行业利润水平分析1103.2.4大陆厂商与业内厂商的技术比较1113.2.5集成电路封装行业影响因素分析111(1)有利因素111(2)不利因素1123.2.6集成电路封装行业发展前景预测113(1)发展趋势分析113(2)前景预测1153.3集成电路封装类专利分析1163.3.1专利分析样本构成116(1)数据库选择116(2)检索方式1163.3.2封装类专利分析116(1)专利公开年度趋势116(2)国内外专利公开趋势对比117(3)国内专利公开主要省市分布118(4)IPC技术分类趋势分布118(5)主要权利人分布情况1193.4集成电路封装过程部分技术问题探讨1203.4.1集成电路封装开裂产生原因分析及对策120(1)封装开裂的影响因素分析120(2)管控影响开裂的因素的方法分析1223.4.2集成电路封装芯片弹坑问题产生原因分析及对策122(1)产生芯片弹坑问题的因素分析122(2)预防芯片弹坑问题产生的方法123第4章中国集成电路封装行业市场需求分析1264.1集成电路市场分析1264.1.1集成电路市场规模1264.1.2集成电路市场结构分析126(1)集成电路市场产品结构分析126(2)集成电路市场应用结构分析1274.1.3集成电路发展销售预测1284.1.4集成电路自给率1284.1.5集成电路市场发展预测1294.2集成电路封装行业需求分析1304.2.1计算机领域对行业的需求分析130(1)计算机市场发展现状130(2)集成电路在计算机领域的应用131(3)计算机领域对行业需求的拉动1314.2.2消费电子领域对行业的需求分析132(1)消费电子市场发展现状132(2)集成电路在消费电子领域的应用136(3)消费电子领域对行业需求的拉动1364.2.3通信设备领域对行业的需求分析137(1)通信设备市场发展现状137(2)集成电路在通信设备领域的应用138(3)通信设备领域对行业需求的拉动1384.2.4工控设备领域对行业的需求分析139(1)工控设备市场发展现状139(2)集成电路在工控设备领域的应用140(3)工控设备领域对行业需求的拉动1404.2.5汽车电子领域对行业的需求分析140(1)汽车电子市场发展现状140(2)集成电路在汽车电子领域的应用141(3)汽车电子领域对行业需求的拉动1414.2.6其他应用领域对行业的需求分析142第5章中国集成电路封装行业市场竞争分析1445.1集成电路封装行业竞争结构波特五力模型分析1445.1.1现有竞争者之间的竞争1445.1.2关键要素的供应商议价能力分析1455.1.3消费者议价能力分析1455.1.4行业潜在进入者分析1465.1.5替代品风险分析1465.2集成电路封装行业国际竞争格局分析1465.2.1国际集成电路封装市场总体发展状况1465.2.2国际集成电路封装市场竞争状况分析1475.2.3国际集成电路封装市场发展趋势分析148(1)封装技术的高密度、高速和高频率以及低成本148(2)主板材料的变化趋势1515.2.4跨国企业在华市场竞争力分析152(1)台湾日月光集团竞争力分析1521)企业发展简介1522)企业经营情况分析1533)企业主营产品及应用领域1534)企业市场区域及行业地位分析1535)企业在中国市场投资布局情况154(2)美国安靠(Amkor)公司竞争力分析1541)企业发展简介1542)企业经营情况分析1543)企业主营产品及应用领域1544)企业市场区域及行业地位分析1545)企业在中国市场投资布局情况155(3)台湾矽品公司竞争力分析1551)企业发展简介1552)企业经营情况分析1553)企业主营产品及应用领域1564)企业市场区域及行业地位分析1565)企业在中国市场投资布局情况157(4)新加坡STATS-ChipPAC公司竞争力分析1571)企业发展简介1572)企业经营情况分析1573)企业主营产品及应用领域1574)企业市场区域及行业地位分析1575)企业在中国市场投资布局情况157(5)力成科技股份有限公司竞争力分析1581)企业发展简介1582)企业经营情况分析1583)企业主营产品及应用领域1584)企业市场区域及行业地位分析1585)企业在中国市场投资布局情况158(6)飞思卡尔公司竞争力分析1581)企业发展简介1582)企业经营情况分析1593)企业主营产品及应用领域1594)企业市场区域及行业地位分析1595)企业在中国市场投资布局情况159(7)英飞凌科技公司竞争力分析1601)企业发展简介1602)企

业经营情况分析1603) 企业主营产品及应用领域1604) 企业市场区域及行业地位分析1605) 企业在中国市场投资布局情况1615.3集成电路封装行业国内竞争格局分析1615.3.1国内集成电路封装行业竞争格局分析1615.3.2国内集成电路封装行业集中度分析162(1) 行业销售收入集中度分析162(2) 行业利润集中度分析163(3) 行业工业总产值集中度分析1645.3.3中国集成电路封装行业国际竞争力分析165第6章 中国集成电路封装行业产品市场分析1666.1集成电路封装行业BGA产品市场分析1666.1.1BGA封装技术水平1666.1.2BGA产品主要应用领域1686.1.3BGA产品需求拉动因素1686.1.4BGA产品市场规模分析1696.1.5BGA产品市场前景展望1696.2集成电路封装行业SIP产品市场分析1706.2.1SIP封装技术水平1706.2.2SIP产品主要应用领域1726.2.3SIP产品需求拉动因素1736.2.4SIP产品市场规模分析1736.2.5SIP产品市场前景展望1746.3集成电路封装行业SOP产品市场分析1756.3.1SOP封装技术水平1756.3.2SOP产品主要应用领域1766.3.3SOP产品市场发展现状1776.3.4SOP产品市场前景展望1776.4集成电路封装行业QFP产品市场分析1786.4.1QFP封装技术水平1786.4.2QFP产品主要应用领域1796.4.3QFP产品市场发展现状1796.4.4QFP产品市场前景展望1796.5集成电路封装行业QFN产品市场分析1796.5.1QFN封装技术水平1796.5.2QFN产品主要应用领域1816.5.3QFN产品市场发展现状1816.5.4QFN产品市场前景展望1816.6集成电路封装行业MCM产品市场分析1826.6.1MCM封装技术水平概况182(1) 概念简介182(2) MCM封装分类1826.6.2MCM产品主要应用领域1836.6.3MCM产品需求拉动因素1836.6.4MCM产品市场发展现状1856.6.5MCM产品市场前景展望1856.7集成电路封装行业CSP产品市场分析1866.7.1CSP封装技术水平概况186(1) 概念简介187(2) CSP产品特点187(3) CSP封装分类188(4) CSP封装工艺流程1896.7.2CSP产品主要应用领域1916.7.3CSP产品市场发展现状1916.7.4CSP产品市场前景展望1926.8集成电路封装行业其他产品市场分析1936.8.1晶圆级封装市场分析193(1) 概念简介193(2) 产品特点194(3) 主要应用领域195(4) 市场规模与主要供应商196(5) 前景展望1976.8.2覆晶/倒封装市场分析197(1) 概念简介197(2) 产品特点197(3) 市场前景1986.8.33D封装市场分析198(1) 概念简介198(2) 封装方法198(3) 发展现状与前景199第7章 中国集成电路封装行业主要企业经营分析2007.1集成电路封装企业发展总体状况分析2007.1.1集成电路封装行业制造商工业总产值排名2007.1.2集成电路封装行业制造商销售收入排名2007.1.3集成电路封装行业制造商利润总额排名2017.2集成电路封装行业企业个案分析2027.2.1飞思卡尔半导体(中国)有限公司经营情况分析202(1) 企业发展简况分析202(2) 企业产销能力分析203(3) 企业盈利能力分析203(4) 企业运营能力分析204(5) 企业偿债能力分析204(6) 企业发展能力分析204(7) 企业产品结构及新产品动向205(8) 企业销售渠道与网络205(9) 企业经营状况优劣势分析2057.2.2威讯联合半导体(北京)有限公司经营情况分析206(1) 企业发展简况分析206(2) 企业产销能力分析206(3) 企业盈利能力分析206(4) 企业运营能力分析207(5) 企业偿债能力分析207(6) 企业发展能力分析208(7) 企业产品结构及新产品动向209(8) 企业销售渠道与网络209(9) 企业经营状况优劣势分析2097.2.3江苏长电科技股份有限公司经营情况分析209(1) 企业发展简况分析209(2) 主要经济指标分析210(3) 企业盈利能力分析210(4) 企业运营能力分析211(5) 企业偿债能力分析212(6) 企业发展能力分析212(7) 企业组织架构分析213(8) 企业产品结构及新产品动向214(9) 企业销售渠道与网络214(10) 企业经营状况优劣势分析215(11) 企业投资兼并与重组分析215(12) 企业新发展动向分析2167.2.4上海松下半導體有限公司经营情况分析216(1) 企业发展简况分析216(2) 企业产销能力分析217(3) 企业盈利能力分析217(4) 企业运营能力分析218(5) 企业偿债能力分析218(6) 企业发展能力分析219(7) 企业产品结构及新产品动向219(8) 企业销售渠道与网络220(9) 企业经营状况优劣势分析2207.2.5深圳赛意法微电子有限公司经营情况分析220(1) 企业发展简况分析220(2) 企业产销能力分析220(3) 企业盈利能力分析221(4) 企业运营能力分析221(5) 企业偿债能力分析222(6) 企业发展能力分析222(7) 企业产品结构及新产品动向223(8) 企业销售渠道与网络223(9) 企业经营状况优劣势分析223(10) 企业新发展动向分析224.....另有1家企业分析。第8章 中国集成电路封装行业动态评估建议3178.1集成电路封装行业投资特性分析3178.1.1集成电路封装行业进入壁垒317(1) 技术壁垒317(2) 资金壁垒317(3) 人才壁垒317(4) 严格的客户认证制度3178.1.2集成电路封装行业盈利模式3188.1.3集成电路封装行业盈利因素3188.2集成电路封装行业投资兼并与重组分析3198.2.1集成电路封装行业投资兼并与重组整合概况3198.2.2国际集成电路封装企业投资兼并与重组整合分析3198.2.3国内集成电路封装企业投资兼并与重组整合分析322(1) 通富微电公司投资兼并与重组分析322(2) 华天科技公司投资兼并与重组分析323(3) 长电科技公司投资兼并与重组分析3248.2.4集成电路封装行业投资兼并与重组整合趋势分析3258.3集成电路封装行业投融资分析3268.3.1电子发展基金对集成电路产业的扶持分析326(1) 电子发展基金对集成电路产业的扶持情况326(2) 电子发展基金对集成电路产业的扶持建议3288.3.2集成电路封装行业融资成本分析3288.3.3半导体行业资本支出分析3288.4集成电路封装行业投资建议3308.4.1集成电路封装行业投资机会分析3308.4.2集成电路封装行业投资风险分析3318.4.3集成电路封装行业投资建议333(1) 投资区域建议333(2) 投资产品建议334(3) 技术升级建议335 图表目录图表1

2019-2023年世界经济增长率及预测（季度环比折年率，%）38图表2
2019-2023年中国国内生产总值同比增长速度（单位%）40图表3
2019-2023年中国规模以上工业增加值增速（单位%）41图表4
2019-2023年全国固定资产投资（不含农户）同比增速（单位%）41图表5
2019-2023年中国社会消费品零售总额同比增速（单位%）42图表6
2019-2023年中国货物进出口总额（单位亿美元）43图表7
2019-2023年中国广义货币（M2）增长速度（单位%）43图表8
2019-2023年中国居民消费者价格指数同比增长情况（单位%）44图表9 封装技术的演进45图表10
各种集成电路封装形式应用领域46图表11 集成电路封装工艺流程47图表12
集成电路产业链示意图51图表13 2019-2023年中国集成电路销售额增长趋势（单位亿元，%）52图表14
2019-2023年中国集成电路产量及增长情况（单位万块，%）53图表15
2019-2023年中国半导体销售额增长趋势（单位亿元，%）53图表16
中国集成电路产业长三角地区分布概况56图表17
2019-2023年中国集成电路进口统计（单位亿个美元/个）60图表18
2019-2023年中国集成电路产业销售情况（单位亿元%）62图表19
2019-2023年集成电路制造业规模分析（单位家，人，万元）66图表20
2019-2023年中国集成电路制造业盈利能力分析（单位%）66图表21
2019-2023年中国集成电路制造业运营能力分析（单位次）67图表22
2019-2023年中国集成电路制造业偿债能力分析（单位%，倍）67图表23
2019-2023年中国集成电路制造业发展能力分析（单位%）68图表24
2019-2023年集成电路制造业主要经济指标统计表（单位万元，人，家，%）69图表25
2019-2023年不同规模企业数量比重变化趋势图（单位%）70图表26
2019-2023年不同规模企业资产总额比重变化趋势图（单位%）71图表27
2019-2023年不同规模企业销售收入比重变化趋势图（单位%）71图表28
2019-2023年不同规模企业利润总额比重变化趋势图（单位%）72图表29
2019-2023年不同性质企业数量比重变化趋势图（单位%）73图表30
2019-2023年不同性质企业资产总额比重变化趋势图（单位%）73图表31
2019-2023年不同性质企业销售收入比重变化趋势图（单位%）74图表32
2019-2023年不同性质企业利润总额比重变化趋势图（单位%）74图表33
2019-2023年居前的10个省市销售收入统计表（单位万元，%）75图表34
2019-2023年居前的10个省市销售收入比重图（单位%）76图表35
2019-2023年居前的10个省市资产总额统计表（单位万元，%）77图表36
2019-2023年居前的10个省市资产总额比重图（单位%）78图表37
2019-2023年居前的10个省市负债统计表（单位万元，%）78图表38
2019-2023年居前的10个省市负债比重图（单位%）79图表39
2019-2023年居前的10个省市销售利润统计表（单位万元，%）80图表40
2019-2023年居前的10个省市销售利润比重图（单位%）81图表41
2019-2023年居前的10个省市利润总额统计表（单位万元，%）81图表42
2019-2023年居前的10个省市利润总额比重图（单位%）82图表43
2019-2023年居前的10个省市产成品统计表（单位万元，%）83图表44
2019-2023年居前的10个省市产成品比重图（单位%）84图表45
2019-2023年居前的10个省市单位数及亏损单位数统计表（单位家）84图表46
2019-2023年居前的10个省市企业单位数比重图（单位%）85图表47
2019-2023年居前的10个亏损省市亏损总额统计表（单位万元，%）86图表48
2019-2023年居前的10个亏损省市亏损总额比重图（单位%）87图表49
2019-2023年集成电路制造业工业总产值及增长率走势（单位亿元，%）88图表50
2019-2023年集成电路制造业产成品及增长率走势图（单位亿元，%）88图表51
2019-2023年集成电路制造业销售产值及增长率变化情况（单位亿元，%）89图表52
2019-2023年集成电路制造业销售收入及增长率变化趋势图（单位亿元，%）90图表53
全国集成电路制造业产销率变化趋势图（单位%）90图表54
2019-2023年费城半导体指数与道琼斯指数走势92图表55

2019-2023年台湾电子零组件指数与台湾加权指数走势93图表56
2019-2023年中国大陆CSRC电子行业指数与沪深300指数走势93图表57
近年全球半导体产值情况（单位十亿美元）94图表58
近年全球各区域半导体产值增长情况（单位%）95图表59
2019-2023年全球半导体市场月度销售额及增长率（单位亿美元，%）96图表60
2024-2030年全球半导体市场规模预测（单位十亿美元）97图表61
2019-2023年美国半导体市场月度销售额及增长率（单位亿美元，%）97图表62
2019-2023年欧洲半导体市场月度销售额及增长率（单位亿美元，%）98图表63
2019-2023年亚太半导体市场月度销售额及增长率（单位亿美元，%）99图表64
2019-2023年全球半导体20强排名（单位亿美元，%）100图表65
2019-2023年美国和日本半导体设备BB值103图表66
2018-2023年美国半导体设备BB值（单位百万美元）103图表67
2019-2023年以来日本半导体设备BB值（单位百万美元）104图表68 半导体行业景气预测模型104图表69
2019-2023年中国品牌厂商智能手机出货量预测（单位百万部%）105图表70
2024-2030年全球平板电脑发展与成熟市场出货量预测（万台%）105图表71
二三线IDM近年来开始向轻资产转型107图表72 2001年以来封装环节
产值占比走势图（单位亿美元，%）108图表73
近年中国封装测试行业销售收入及增长情况（单位亿元，%）109图表74
近年中国封装测试企业地域分布情况（单位家）110图表75
国内封测厂商与行业前五封测厂商主要技术对比111图表76 封装技术应用领域发展趋势115图表77
近年IC封装类专利公开年度分布（单位件，%）117图表78
近年中国IC封装类专利国内外公开趋势（单位件，%）117图表79
IC封装类专利大陆省市分布（单位件）118图表80 近年IC封装类专利IPC分布趋势（单位件）119图表81
中国IC封装类主要权利人位排名情况（单位件）120图表82 树脂粘度变化曲线图121图表83
后固化时间与抗弯强度关系曲线图（单位h，Mpo）121图表84 切筋凸模的一般设计方法122图表85
2019-2023年中国集成电路市场销售额规模及增长率（单位亿元，%）126图表86
2019-2023年中国集成电路市场产品结构图（单位%）127图表87
2019-2023年中国集成电路市场应用结构图（单位%）127图表88
2019-2023年中国集成电路市场品牌竞争结构（单位%）128图表89
2019-2023年中国集成电路市场规模及增长（单位亿美元，%）129图表90
2019-2023年中国电子计算机制造业主要经济指标（单位家，人，万元，%）130图表91
2019-2023年全球IT支出预测（单位十亿美元，%）131图表92
2019-2023年亚太地区IT支出预测（单位百万美元，%）132图表93
2019-2023年中国通信设备制造业主要经济指标（单位家，万元，%）137图表94
中国集成电路封装测试行业企业类别145图表95
近年全球各封装技术产品产量构成表（单位亿块，%）147图表96
2019-2023年度全球大集成电路封装测试企业排名（单位百万美元，%）148图表97
各种电子产品的介电常数149图表98
DNP将部件内置底板“B2it”薄型化151图表99 “MEGTRON4”的电气特性和耐热性152图表100
2019-2023年台湾矽品公司简明损益表（单位百万台币）156图表101
2019-2023年中国集成电路封装测试企业（单位亿元）162图表102
2019-2023年中国集成电路制造行业前10名企业销售额及销售份额（单位万元，%）163图表103
2019-2023年中国集成电路制造行业前10名企业利润情况（单位万元，%）164图表104
2019-2023年中国集成电路制造行业前10名企业工业总产值情况（单位万元，%）165图表105
PBGA（塑料焊球阵列）封装167图表106 CMMB应用市场结构（单位%）168图表107
CMMB芯片产业链示意图169图表108 带有倒装、打线等多种技术的3DSIP封装示意图171图表109
SOP封装产品175图表110 QFN生产工艺流程图180图表111 QFN产品厚度的演变181图表112
几种类型CSP结构组成图192图表113 晶圆级封装（WLP）简介193图表114
晶圆级封装（WLP）的优点194图表115 晶圆级封装（WLP）简介196图表116
晶圆级封装市场规模（单位百万美元，%）197图表117
2023年中国集成电路封装行业制造商工业总产值（现价）排名位（单位万元）200图表118

2019-2023年中国集成电路封装行业制造商销售收入排名位（单位万元）201图表119
2019-2023年中国集成电路封装行业制造商利润总额排名位（单位万元）202图表120
2019-2023年飞思卡尔半导体（中国）有限公司产销能力分析（单位万元）203